

华泰联合证券有限责任公司
关于河南仕佳光子科技股份有限公司
2023 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：仕佳光子
保荐代表人姓名：刘鹭	联系电话：025-83387753
保荐代表人姓名：李威	联系电话：021-38966585

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“仕佳光子”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，对仕佳光子进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

发行人2023年半年度报告显示，公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为-1,772.15万元，同比下降153.88%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,234.94万元，同比下降238.91%，下降幅度较大。保荐机构知悉上述情况后，通过高管访谈、查阅相关公告文件和财务资料等方式对公司经营情况、财务情况以及未来发展进行了研究，了解公司业绩下滑的主要原因。

经核查，保荐机构认为：

公司2023年半年度业绩下滑主要原因系受宏观环境、行业发展等因素影响，公司主营业务市场需求及部分产品价格有所下降，使得营业收入有所减少、部分产品毛利率下降，毛利额减少；同时，公司持续进行研发和技术创新，研发费用有所增加，同比增长26.30%；此外，公司按谨慎性原则，基于业务发展及行业变动等因素，对存货计提存货跌价准备。经核查，公司业务开展及生产情况正常、核心竞争力未发生重大不利变化。对于公司未来的经营状况，保荐机构督促上市公司持续关注业务发展情况，同时不断推动研发进展，及时披露相关信息。

二、重大风险事项

公司目前面临的主要风险因素如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术升级迭代风险

公司经过多年的持续研发投入，在无源芯片（PLC 分路器芯片、AWG 芯片等）、有源芯片（DFB 激光器芯片等）领域，围绕芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试等各业务环节形成了一系列技术积累。同时，公司借助在室内光缆领域多年的业务积累，持续整合在“光纤连接器—室内光缆—线缆材料”方面的协同能力和技术优势。随着全球光通信技术的不断演进，技术革新产品迭代加速、应用领域不断拓展已成为行业发展趋势。若公司不能继续保持充足的研发投入，或者在关键技术上未能持续创新，亦或新产品技术指标无法达到预期，则面临核心技术竞争力降低的风险，可能在市场竞争中处于劣势，面临市场份额降低的情况。

2、研发失败风险

光通信行业属于技术密集型行业，具有研发投入高、研发周期长、研发风险大的特点。公司在研发新产品的过程中，也存在下游客户的产品导入和认证过程，需要接受周期较长、标准较为严格的多项测试。若公司未能准确把握下游行业客户的应用需求，未能正确理解行业及相关核心技术的发展趋势，无法在新产品、新工艺等领域取得持续进步，可能导致公司产品研发失败，或因稳定性差、应用难度大、成本高昂、与下游客户需求不匹配等因素，导致公司新产品无法顺利通过下游客户的产品导入和认证，会对公司的经营业绩造成不利影响。

3、关键技术人才流失风险

目前国内光通信行业关键技术人才较为稀缺。公司已向技术团队提供了富有竞争力的薪酬待遇和股权激励，以提高技术团队的忠诚度和稳定性。但随着光通信行业的持续发展，人才竞争将不断加剧，若公司的关键技术人才大量流失，将对公司技术研发能力和经营业绩造成不利影响。

（二）经营风险

1、市场竞争加剧风险

公司主要产品价格受到市场需求情况、行业竞争态势等因素影响。公司产品处于光通信产业链上游，其需求直接受到下游电信市场和数据中心市场发展态势的影响。此外，近年来，国内光通信行业呈现出较快的发展态势，随着国际企业与国内新进入者不断增加，公司面临行业竞争加剧的风险。综上，若下游市场发展未达预期，通信、云计算等终端市场需求下降，数据流量需求下滑、应用场景不成熟等因素导致 5G 建设、数据中心建设大幅推迟，或者竞争对手采用低价竞争等策略激化市场竞争态势，有可能导致公司产品价格出现大幅下降的情形，并最终造成公司盈利能力下降。

2、产品质量控制的风险

公司重视产品质量管理，建立了严格的质量控制制度，运用质量保证策略和质量工具，在产品生命周期内进行全流程在线监控，建立了覆盖原材料采购、产品生产、产品入库的全过程质量控制体系，并通过了 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、OHSAS18001: 2007 “三标一体”体系认证。由于光通信产品尤其光芯片生产工艺较复杂，若某一环节因质量控制疏忽而导致产品出现质量问题，将会对公司品牌形象、市场拓展、经营业绩产生不利影响。

（三）行业风险

1、行业竞争风险

随着我国数据中心、5G 等光通信行业的蓬勃发展，国际上对光学芯片、器件的需求快速增长，也吸引了国内外企业的进入，竞争也日趋激烈。一方面，国内光电芯片企业数量在不断增加，另一方面，全球范围内的竞争越来越激烈。如果公司不能持续进行技术升级和迭代，持续提高产品的性能和良率、提高服务质量和响应速度，则可能使公司产品失去竞争力。

2、产业政策风险

光芯片和器件作为光通信网络的基石，尤其是 5G 更是国家抢占技术制高点的必争之地，国家出台了多项政策鼓励我国光电产业发展，如果未来国家相关政策发生变化，公司的经营业绩可能会受到影响。

（四）宏观环境风险

1、宏观经济及行业波动风险

公司产品处于光通信产业链上游，其需求直接受到下游电信市场和数据中心市场发展态势的影响。如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致通信、云计算等终端市场需求下降，或者数据流量需求下滑、应用场景不成熟等因素导致 5G 建设、数据中心建设大幅推迟，将对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。

2、国际贸易争端加剧风险

公司积极开拓海外市场，密切关注海外光通信市场的发展趋势，通过在美国设立子公司以及加强销售团队力量等方式，加大对海外市场的推广力度。2018 年以来，中国面临的国际贸易环境有所恶化，如果未来中国对外贸易争端进一步加剧，有可能对公司的生产经营和业务扩张造成不利影响。

三、重大违规事项

无。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年上半年，公司主要财务数据及指标情况如下：

单位：万元

主要财务数据	2023年1-6月/ 2023年6月30日	2022年1-6月/ 2022年12月31日	增减幅度（%）
营业收入	32,990.27	42,910.18	-23.12
归属于上市公司股东的净利润	-1,772.15	3,289.15	-153.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,234.94	2,328.77	-238.91
经营活动产生的现金流量净额	4,200.86	3,630.05	15.72
归属于上市公司股东的净资产	116,978.67	120,467.88	-2.90
总资产	147,507.42	157,481.14	-6.33
主要财务指标	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度（%）
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.07	-155.86

主要财务数据	2023年1-6月/ 2023年6月30日	2022年1-6月/ 2022年12月31日	增减幅度(%)
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.07	-155.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	0.05	-242.60
加权平均净资产收益率(%)	-1.48	2.70	减少4.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.70	1.91	减少4.61个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	14.94	9.09	增加5.85个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1、本期营业收入较上年同期下降23.12%，主要系受宏观环境、行业发展等因素影响，相关市场需求下降及部分产品降价所致；

2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降153.88%和238.91%；基本每股收益和稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别下降155.86%和242.60%，主要系营业收入有所减少，部分产品降价导致毛利率下降，毛利额减少；同时，公司持续进行研发和技术创新，研发费用有所增加，同比增长26.30%；此外，公司按谨慎性原则，基于业务发展及行业变动等因素，对存货计提存货跌价准备；

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长15.72%，主要系公司收到的政府补助增加，同时加强应收账款、库存等营运资金的管理。

五、核心竞争力的变化情况

针对光通信、数据中心、光传感行业最为核心的芯片产品，公司利用研发和产业化积累的经验，自主搭建了涵盖芯片设计、晶圆生长、芯片加工、封装测试的光无源/有源IDM全流程制造体系。经过十余年的成长，从初创期的单一PLC分路器芯片发展至今，已经形成无源PLC分路器芯片、AWG芯片、VOA芯片以及光器件、组件、模块系列，有源DFB激光器芯片、高功率激光器芯片、传感类芯片、器件等信息光电子领域的两大类系列产品，无源+有源双平台优势愈发凸显，成为国内光通信行业具备核心竞争力的科技型企业。

1、产学研结合的技术团队优势

公司高度重视人才培养和研发队伍的建设,不断吸引外部优秀人才加入公司,不断壮大公司的自主研发实力。同时,在国家鼓励高校、科研院所实施科技成果转化的政策导向下,公司自2010年起与中科院半导体所长期维持良好的院企合作关系,中科院半导体所既是公司股东,也向公司派出多名专家顾问,长期稳定向公司提供技术支持,加快公司的研发进展。

报告期内,公司已构建起包括273名研发人员及10名中科院专家顾问在内的研发队伍,研发方向涵盖无源芯片、无源封装、有源芯片、有源封装、光电集成、其他光器件等各领域。通过持续研发投入,公司已围绕光芯片等核心领域建立起较为完备的工艺平台,鼓励研发人员持续深入参与公司技术研发及项目开发,不断提升公司的技术实力。

公司秉承合作共赢的团队精神和利益共享的激励政策,公司骨干员工以及中科院专家顾问都持有公司股份,实现了公司核心人才团队的稳定。通过持续的研发投入,公司已围绕光芯片等核心领域建立起完备的有源和无源工艺平台,凭借研发团队多年的努力以及持续不断地研发投入,公司成功地产业化了具有市场竞争力的多款光芯片,积累了丰富的研发和产业化密切结合的经验 and 产业化技术、专利储备。

2、持续高水平的研发投入,积累了芯片产业化技术研发优势

公司针对行业和市场发展动态,逐步探索并明确研发方向及产品演进路线,建立健全研发体系和研发管理制度,加强对研发组织管理和研发过程管理,不断强化芯片设计、晶圆制造、芯片加工及封装测试等工艺积累,在核心技术方面屡获突破,打造了自身在光芯片领域的核心能力。

公司已形成石英基及硅基微透镜及其制造技术、新型倒台脊形波导结构及DFB激光器芯片制作技术、InP基多量子阱外延技术、高精度布拉格光栅制作及波长精准控制技术在内的多项核心技术。公司还在数据中心400G/800G用O波段AWG芯片技术、5G基站前传AWG芯片技术、硅基二氧化硅热光可调光衰减器(VOA)阵列芯片技术、面向5G通信应用DFB激光器芯片技术等领域形成良好

的技术储备。同时，公司拥有授权专利等各类知识产权260项（其中发明专利39项）。

借助技术积累优势，公司先后牵头主持国家科技部863项目、国家重点研发计划项目、国家工信部专项、国家发改委专项等重大科研项目，设立了光电子集成技术国家地方联合工程实验室、河南省光电子技术院士工作站、博士后科研工作站、光电集成河南省工程实验室、河南省光电子集成工程技术研究中心等研发平台。2017年，公司“光网络用光分路器芯片及阵列波导光栅芯片关键技术及产业化”获国家科技进步二等奖；2020年，公司无源分路器获得国家工信部认定制造业“单项冠军”产品。

3、以芯片为核心的产品结构优势

公司秉承“以芯为本”的理念，保持对光芯片及器件的持续研发投入，努力打造自主芯片的核心能力，并围绕光芯片进行横向拓展和纵向延伸：在横向拓展方面，公司从单一PLC分路器芯片突破至系列无源芯片（PLC分路器芯片、AWG芯片）、有源芯片（DFB激光器芯片），并逐步开发微透镜芯片，VOA芯片，未来向有源+无源的光电集成方向演进，紧跟行业发展趋势；在纵向延伸方面，公司以晶圆、芯片为基础，通过封装工艺技术的不断提升，由芯片逐步向器件模块领域延伸。公司产品应用于光纤到户、数据中心、5G建设等诸多领域，并且在部分光芯片产品方面成功实现了国产化和进口替代。

4、客户资源优势

随着公司技术水平的提升，以及产品线布局的丰富，公司的客户结构也不断优化。公司定位大客户战略，在国内市场上，公司不断加强与主流系统设备商类客户的业务合作，并通过AWG芯片、DFB激光器芯片等新产品逐步开拓新客户；在国际市场上，加大对海外市场的市场推广力度，报告期内陆续开拓了国际光模块类知名客户，对前期存量海外客户的销售规模也不断扩大。公司借助自主芯片核心能力构建的技术实力，加大新产品的市场开拓力度。公司借助芯片到器件的全流程IDM模式，以更快的响应速度，更好的服务，为优质客户提供更多更高性价比的产品，跟随客户一起发展。公司积极拓展海外市场，逐步提升公司在海外市场的影响力，积累了优质的客户资源，为公司未来的业务发展打下良好的基础。

六、研发支出变化及研发进展

2023年1-6月，公司研发投入4,928.48万元，占营业收入比例为14.94%，较上年同期增长26.30%。

公司以技术创新为核心，建立健全研发体系和研发管理制度，加强对研发组织管理和研发过程管理，不断强化芯片设计、晶圆制造、芯片加工及封装测试等工艺积累，在核心技术方面屡获突破，是国内同时具有无源芯片和有源芯片的双平台IDM模式企业。报告期内，公司持续围绕行业技术发展趋势和客户未来需求进行前瞻性技术储备，在聚焦千兆宽带接入、骨干网相干通讯、高速数据中心用核心光无源/有源芯片等优势产品基础上，重点对400G/800G光模块用AWG、平行光组件、连续波高功率激光器等芯片及组件，相干通讯用超宽带密集波分复用AWG等关键技术持续攻坚，现已实现客户验证及小批量出货。同时，针对光通信行业应用场景多元化、复杂化的发展趋势，公司凭借在室内光缆领域的多年业务积累，持续整合在“光纤连接器—室内光缆—线缆材料”方面的协同优势，通过不断改进各产品环节的性能指标提升光纤连接器等产品整体竞争力，依托光芯片及器件、室内光缆以及线缆材料协同发展，公司在光通信行业的综合竞争力稳步提升。

2023年上半年，公司新增专利申请数11项，其中发明专利8项，实用新型专利3项；新增获得授权专利数量7项，其中发明专利1项，实用新型专利6项。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

截止2022年12月31日，公司募集资金余额为0元，募集资金已于2022年度使用完毕，且相关募集资金专户已于2022年末前注销完毕，2023年1-6月不存在使用募集资金的情形。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质

押、冻结及减持情况

2023年上半年，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况如下：

名称	职务	期初直接持股数	期末直接持股数	直接持股增减变动	增减变动原因及持股情况
河南仕佳信息技术有限公司	控股股东	102,629,667	102,629,667	-	直接持有公司 102,629,667 股
葛海泉	董事长、总经理	30,541,172	30,541,172	-	直接持有公司 30,541,172 股，并持有河南仕佳信息技术有限公司 42.56% 的股份
安俊明	董事	5,400,000	4,050,000	-1,350,000	二级市场减持；直接持有 4,050,000 股
吴远大	董事、副总经理	5,580,000	4,280,000	-1,300,000	二级市场减持；直接持有 4,280,000 股
吕克进	董事、副总经理	1,978,104	1,490,713	-487,391	二级市场减持；直接持有 1,490,713 股
张志奇	董事	718,905	540,105	-178,800	二级市场减持；直接持有 540,105 股
丁建华	董事	807,039	607,039	-200,000	二级市场减持；直接持有 607,039 股
刘德明	独立董事	-	-	-	不适用
张大明	独立董事	-	-	-	不适用
中华萍	独立董事	-	-	-	不适用
侯作为	监事会主席	1,080,000	810,000	-270,000	二级市场减持；直接持有 810,000 股
吕豫	监事	-	-	-	不适用
雷杰	监事	540,000	405,000	-135,000	二级市场减持
吴卫锋	监事	45,000	-	-45,000	二级市场减持
赵艳涛	财务总监、董事会秘书	-	-	-	不适用

郭伟 ^注	监事	-	-	-	不适用
赵鹏 ^注	监事	270,000	270,000	-	不适用

注：郭伟已于2023年5月离任；赵鹏已于2023年2月离任

截至2023年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



刘 懿



李 威

华泰联合证券有限责任公司



2023年8月29日